

# 招商证券股份有限公司

## 关于上海概伦电子股份有限公司

### 2024 年半年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海概伦电子股份有限公司（以下简称“概伦电子”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责概伦电子上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。

#### 一、重大风险的结论性意见

公司 2024 年 1-6 月（以下简称“报告期”）归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-4,088.37 万元、-1,896.47 万元，同比 2023 半年度分别下降 6,402.04%和 368.67%（2023 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润与扣除非经常性损益的净利润分别为 64.87 万元及 -404.65 万元），主要原因系公司本报告期内研发投入持续增加、计提股份支付费用及投资交易性金融资产亏损所致。2024 年上半年，公司持续进行现有产品升级及新产品开发，研发投入保持了较高增速；同时，为了稳定现有研发团队并吸引高端人才加盟，增强公司的长期竞争力，公司于 2023 年 2 月实施了限制性股票激励计划，报告期内摊销了大额股份支付费用，影响了公司本报告期的利润水平；此外，公司持有的交易性金融资产公允价值变动亦给本报告期的利润带来一定损失。2024 年上半年，公司主营业务、核心竞争力、其他主要财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势相一致；公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形；公司的持续经营能力不存在重大风险。

#### 二、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，	保荐机构已与概伦电子签订《保荐协议》，该协议明确了双方在

序号	工作内容	持续督导情况
	明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，了解概伦电子业务情况，对概伦电子开展了持续督导工作
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2024年半年度概伦电子在持续督导期间未发生按有关规定须保荐机构公开发表声明的违法违规情况
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2024年半年度概伦电子在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	在持续督导期间，保荐机构督导概伦电子及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促概伦电子依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对概伦电子的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，概伦电子的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促概伦电子严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对概伦电子的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2024年半年度，概伦电子及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生前述情况

序号	工作内容	持续督导情况
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2024年半年度，概伦电子及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2024年半年度，经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2024年半年度，概伦电子未发生前述情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求
16	上市公司出现以下情形之一的，保荐人应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项	2024年半年度，概伦电子未发生前述情况

### 三、保荐机构对公司信息披露审阅的情况

保荐机构持续督导人员对公司的股东大会、董事会及监事会会议文件、募集资金使用和管理的相关报告等文件进行了检查。

经核查，保荐机构认为，概伦电子严格按照证券监督部门的相关规定进行了信息披露，依法公开对外发布各类定期报告或临时报告，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 四、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

## 五、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

### （一）股份支付费用增加可能导致公司业绩大幅下滑或亏损的风险

为进一步提升公司核心竞争力，公司基于 DTCO（设计-工艺协同优化）方法学，持续进行战略产品的升级完善及新产品的研发布局，不断加大研发投入，研发投入保持了较高增速，占营业收入的比重不断提升，报告期内，公司的研发投入继续保持较高增速，公司营业收入增速有所放缓；同时，为了稳定现有研发团队并吸引高端人才加盟，增强公司的长期竞争力，公司于 2023 年 2 月实施了限制性股票激励计划，报告期内摊销了大额股份支付费用，直接影响了公司的利润水平。EDA 行业是技术密集型行业，考虑到公司目前的盈利水平相对较低，公司持续进行产品创新导致的研发费用增加，实施股权激励导致的股份支付费用增加，可能导致公司在一定期间内持续亏损。

### （二）技术升级迭代风险

集成电路行业需要创新驱动，EDA 行业处于集成电路行业最上游，是实现技术创新的源头，其自身的创新尤为重要。EDA 行业发展需契合集成电路行业的技术发展趋势，根据市场需求变动和工艺水平发展及时对现有技术进行升级换代，以持续保持产品竞争力。公司下游客户多为集成电路行业内全球知名企业，其对 EDA 工具的技术领先性要求较高，公司需要持续满足行业动态发展的需求，且时刻面对国际竞争对手产品快速升级迭代的技术竞争。未来若公司的技术升级迭代进度和成果未达预期，致使技术水平落后于行业升级迭代水平，将影响公司产品竞争力并错失市场发展机会，对公司未来业务发展造成不利影响。

### （三）研发成果未达到预期或研发投入超过预期的风险

公司所处 EDA 行业属于技术含量较高的知识产权密集型领域，具有研发投入大、研发周期长的特征。公司需要持续对现有产品的升级更新和新产品的开发进行较高强度研发投入，以适应不断变化的市场需求。公司近年来持续加大研发投入，并预计将在未来继续保持较高比例研发投入。在公司研发投入占比较高的情况下，如果公司研发新产品或对现有产品升级效果不及预期，研发出

的产品无法满足下游客户的需求或与竞争对手产品相比处于劣势，公司将面临研发投入难以收回的风险，进而影响后续进一步研发投入，对公司业绩和竞争力产生不利影响。

同时，面对快速变化的集成电路行业发展以及竞争对手不断增强的技术竞争水平，公司对新产品的开发或对现有产品的升级可能产生超过预期的研发投入，可能导致公司出现短期内研发投入与所产生收入失衡的情况，进而对公司短期经营业绩造成不利影响。

#### **（四）研发成果未获得市场认可导致无法形成规模化销售的风险**

由于EDA工具在集成电路行业中所起的关键作用，EDA行业具有产品验证难、市场门槛高的特点，尤其是对于国际知名客户，其对新企业、新产品的验证和认可门槛较高。因此，EDA行业研发成果要转化为受到国际主流市场认可的产品，不仅需要持续大量的研发投入以形成在技术上达到先进水平的产品，还需要较强品牌影响力、渠道能力、快速迭代能力等。如果公司研发出技术上达到先进水平的产品却无法通过国际主流市场验证及认可，则研发成果仍无法形成规模化收入，亦将对公司经营业绩造成不利影响。

#### **（五）技术人员流失及技术人员成本上升风险**

EDA行业属于典型的技术密集型行业，其研发力量主要为高素质的EDA人才，EDA工具的复杂性和开发难度决定了其对相关人才要求的严苛性，往往需要相关人才掌握数学、物理、计算机、芯片设计等多行业交叉的综合性知识。EDA行业人才在全球范围内均较为稀缺，在EDA行业内对技术人员吸引的竞争非常激烈，同时多年来互联网、人工智能等行业的发展吸引了大量具备EDA行业知识和能力的人才进入，进一步造成了EDA行业人才的稀缺。若公司不能通过自身业务发展、行业地位提升、合理的薪酬待遇、各种人才培养计划等综合措施维持研发团队的稳定性，并不断吸引优秀技术人员加盟，则可能无法保持现有技术竞争优势或无法持续研发新技术、新产品，从而对公司的正常经营、研发进展、市场竞争力及未来发展产生不利影响。

#### **（六）EDA市场规模相对有限及市场格局现状导致的竞争风险**

相对于全球集成电路市场，EDA市场规模占比较小。EDA工具存在十分明

显的规模效应，全球 EDA 市场目前基本处于寡头垄断的格局，由新思科技、铿腾电子、西门子 EDA 三家厂商主导，行业集中度较高。在目前寡头垄断的市场竞争格局下，公司要继续在现有产品中拓展下游客户或开发新产品进入主流市场，将面临国际竞争对手激烈的技术及市场竞争，公司在综合竞争能力上较国际竞争对手存在差距，相对国际竞争对手数十亿美金的业务收入，公司现阶段经营规模及相应市场份额较小，在市场声誉、销售网络、产品种类、资金实力等多方面有所落后，公司能否依托现有产品的技术及渠道基础，继续拓展新客户、形成新产品以实现业务持续增长，具有较大不确定性。因此，公司面临 EDA 市场格局现状导致的竞争风险。同时，随着中国集成电路行业的水平和竞争力提升，以及对知识产权保护的加强，我国的 EDA 市场规模会迅速增加，并推动对本土 EDA 需求的提升，从而增强公司作为国内首个登陆资本市场的 EDA 公司在面临 EDA 整体市场规模有限情况下的竞争力。

#### **（七）产品种类丰富度较低的竞争风险**

公司目前主要 EDA 产品包括制造类 EDA 和设计类 EDA，与新思科技、铿腾电子、西门子 EDA 等国际竞争对手相比，公司在产品种类丰富度上存在明显的差距。前述国际竞争对手丰富多样的产品种类可以满足下游客户的多方面需求，为其提供一站式采购选择。公司产品种类相对国际竞争对手较少，导致公司在产品销售协同效应上处于劣势，同时在公司经营中产品失败的风险难以分散，如果公司现有产品在特定时期技术更新有所落后，无法满足客户需求，可能会由于缺少其他可供推广的产品而对公司经营成果及市场地位造成影响。同时，随着公司在研发投入的逐年增加，新产品陆续推向市场并针对特定应用逐步完善其流程和解决方案，特别是公司推出的设计平台产品，针对工艺开发的 DTCO 制造类 EDA 全流程和针对存储器等设计类 EDA 全流程基本形成，产品种类丰富度较低的竞争风险大大降低，与其他国际竞争对手相比其竞争力逐年提升。

#### **（八）经营规模较小的风险**

全球 EDA 市场目前基本处于寡头垄断的格局，新思科技、铿腾电子、西门子 EDA 三家企业市场份额较高，其他 EDA 企业受市场竞争格局限制而普遍经营规模较小。公司经营规模较小在一定程度上限制了公司所能支撑的研发、销

售、收购兼并等活动投入总额，且公司财务数据容易随着外部经济环境或自身经营活动变化而呈现较大波动。同时，公司规模迅速增长，从产品销售和运营等各方面的规模效应会对公司的继续成长起到正面促进的作用，相关的风险会随着公司规模的增大而逐渐降低。

### **（九）无法找到潜在收购或战略投资标的及无法实现业务协同的风险**

EDA 行业产品具有研发投入高、研发周期长、产品验证难度大、市场门槛高等特点，且集成电路设计与制造的链条环节较多且对技术的要求差异较大，因此 EDA 企业一般会采取以内生增长与外延并购相结合的方式来实现企业长期发展与业务成长。

收购或战略投资业务契合的潜在标的并优化整合，将是公司未来发展战略的重要组成部分。公司预计在未来将继续进行 EDA 行业内收购或战略投资，但该等收购或战略投资受到多种制约因素影响，例如境外不同国家或地区相关政策限制、收购成本过高等，若公司无法找到合适标的或在收购后无法有效进行研发、销售、管理等方面的整合协同，则可能会影响公司战略执行及相应经营业绩。为尽可能降低相关风险，公司参与设立了专项投资基金，对部分 EDA 初创项目进行早期投资，从而为公司未来长远的发展进行战略布局。

### **（十）商誉减值的风险**

兼并收购业务契合的潜在标的并优化整合，将是公司未来发展战略的重要组成部分，预计未来随着不断兼并收购，公司将持续形成新的商誉。公司至少每年对收购形成的商誉执行减值测试，如果被收购公司未来经营状况未达预期，则公司存在商誉减值的风险，可能对公司的当期盈利水平产生不利影响。

### **（十一）毛利率波动的风险**

公司业务主要包括 EDA 软件授权、相关半导体器件特性测试系统销售及技术开发解决方案，主营业务毛利率变动主要受业务占比变动及各业务细分毛利率变动影响。一方面，如果公司未来 EDA 软件授权业务占比发生变动，将导致公司主营业务毛利率相应波动；另一方面，报告期内公司半导体器件特性测试系统销售和技术开发解决方案毛利率较高，未来公司必须根据市场需求不断进行技术迭代升级和创新，若公司未能正确判断下游需求变化、技术实力停滞不

前或行业地位下降，该等业务毛利率可能下降，进而导致公司主营业务毛利率下降。上述因素均有可能导致公司主营业务毛利率发生波动，进而相应影响公司经营业绩。

## **（十二）海外市场风险**

公司在美国、韩国、新加坡等地区设有子公司和/或分支机构并积极拓展海外业务。报告期内，公司来源于境外的收入占当期营业收入总额比例略高，海外市场受政策法规变动、政治经济局势变化、知识产权保护、政府贸易限制等多种因素影响。随着公司业务规模的不断扩大，公司涉及的法律环境将会更加复杂，若公司不能及时应对海外市场环境的变化，会对海外经营的业务带来一定的风险。

## **（十三）国际贸易摩擦风险**

近年来，随着全球政治经济形势变化以及产业格局深度调整，国际贸易摩擦逐渐成为企业生产经营必须面对的常态化问题。公司境外业务占比较高，主要为对外销售，进口业务相对较少，主要境外业务区域包括美国、日本和韩国等地区。如果未来国际贸易摩擦进一步加剧，例如中美两国现有贸易摩擦继续恶化，或与中国产生贸易摩擦的国家增加等，则可能对公司正常经营产生不利影响。

## **（十四）汇率波动的风险**

目前，公司业务主要覆盖北美、日本、韩国、中国台湾等地区，结算币种主要包括美元、日元、韩元、新台币等。如在未来期间汇率进一步发生较大变动或不能及时结算，且公司未能采取有效管理措施，则公司将面临利润水平受汇率波动影响的风险。

## **（十五）税收优惠相关的风险**

根据相关规定，报告期内公司及其相关子公司享受多项税收优惠政策，包括增值税退（免）税政策、部分服务免征增值税、可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳税额、软件企业、高新技术企业以及小型微利企业相关所得税优惠政策、研发费用加计扣除等。如果相关政策发生变化或者公司不能持续符合相应政策条件，将对公司的经营业绩和利润水平产生一定程度的影响。

## （十六）知识产权侵权风险

公司业务收入主要来源于 EDA 软件授权，具备核心技术的知识产权是公司保持自身竞争力的关键。自成立以来，公司核心技术以自主研发为主，通过持续不断的研发迭代及探索积累，形成了具有自主知识产权的专业核心技术和相关技术储备。EDA 行业在全球范围内存在较多知识产权被盗用或被不当使用的情形，公司通过申请专利、软件著作权等方式对自主知识产权进行了保护，但无法排除上述知识产权被盗用或被不当使用的风险。若出现知识产权被他人侵权的情况，可能会对公司正常业务经营造成不利影响。

同时，公司一贯重视自主知识产权的研发，避免侵犯第三方知识产权，但仍无法完全排除由于公司员工对知识产权的理解出现偏差等因素而导致的侵犯第三方知识产权的情形，以及竞争对手或其他利益相关方采取恶意诉讼等不当手段阻碍公司业务正常发展的风险。

## 六、重大违规事项

2024年1-6月，公司不存在重大违规事项。

## 七、主要财务指标的变动原因及合理性

2024年1-6月，公司主要财务数据及指标如下所示：

主要会计数据	2024年半年度	2023年半年度	增减变动幅度（%）
营业收入（万元）	19,604.28	15,237.15	28.66
归属于上市公司股东的净利润（万元）	-4,088.37	64.87	-6,402.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	-1,896.47	-404.65	-368.67
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-5,259.51	2,547.57	-306.45
剔除股份支付影响归属于上市公司股东的净利润（万元）	-2,745.47	1,196.71	-329.42
剔除股份支付影响归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	-553.57	727.19	-176.12
主要会计数据	2024年6月末	2023年末	增减变动幅度（%）
归属于上市公司股东的净资产（万元）	201,073.73	209,470.52	-4.01
总资产（万元）	239,636.12	251,881.82	-4.86

主要财务指标	2024年半年度	2023年半年度	增减变动幅度(%)
基本每股收益(元/股)	-0.094	0.001	-9500
稀释每股收益(元/股)	-0.094	0.001	-9500
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.044	-0.009	-388.89
加权平均净资产收益率(%)	-2.00	0.03	减少2.03个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.93	-0.19	减少0.74个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	66.74	59.59	增加7.15个百分点
研发投入合计(万元)	13,084.15	9,080.29	44.09

上述主要财务数据及指标的变动原因具体如下：

(1) 2024年上半年营业收入同比增长28.66%，主要系报告期内拓展产品线，增强产品竞争力，在手订单及新签订单持续增长，EDA授权工具和技术开发解决方案业务收入均实现增长所致。

(2) 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润同比下降6,402.04%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少1,491.82万，主要系报告期内投资交易性金融资产亏损、计提股份支付费用以及研发投入增加所致。

(3) 2024年上半年剔除股份支付影响归属于上市公司股东的净利润同比下降329.42%，剔除股份支付影响归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降176.12%，主要系报告期内投资交易性金融资产亏损、销售及研发投入增加所致。

(4) 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-5,259.51万元，同比下降306.45%，主要是销售商品收到的现金较去年同期减少以及员工人数增长支付工资所支出的现金增加所致。

(5) 基本每股收益、稀释每股收益分别同比减少9,500.00%、9,500.00%，扣除非经常性损益后的基本每股收益减少0.035元/股，系净利润减少所致。

(6) 研发投入较去年同期增长44.09%，主要是研发人员数量增加导致的薪酬增加、计提股份支付费用及与研发相关的无形资产摊销增加所致。

综上，公司2024年半年度主要财务指标变动具备合理性。

## 八、核心竞争力的变化情况

公司的主营业务为向客户提供被全球领先集成电路设计和制造企业长期广泛验证和使用的 EDA 全流程解决方案，主要产品及服务包括制造类 EDA、设计类 EDA、半导体器件特性测试系统和一站式工程服务解决方案等。公司自成立以来一直专注于 EDA 工具的自主设计和研发，在器件建模和电路仿真领域深耕多年，积累了丰厚的技术成果，同时服务了大量知名客户，深刻理解了高端芯片在设计和制造两个环节的痛点和需求，具备了实施 DTCO（设计-工艺协同优化）所需的基础。在此基础上，公司加速推动打造应用驱动的 EDA 全流程战略的实施和落地。公司在核心环节关键 EDA 技术实现了突破，其国际领先性和国际市场竞争力为公司的发展奠定了坚实的基础。以 DTCO 作为核心驱动力，公司加大研发，陆续推出新产品，逐步建立针对工艺开发和制造的制造类 EDA 全流程、以及针对存储器和模拟/混合信号电路设计的设计类 EDA 全流程，并推动我国集成电路行业设计和制造环节的深度联动，提升行业竞争力。

2024 年半年度，公司持续加大研发投入，基于研发业务的需求，积极扩充研发人员数量，以满足公司日益增长的研发业务对人才的需求，并提升公司的研发能力。高强度的研发投入有力支撑了现有产品升级及新产品开发，通过持续不断的技术升级迭代以促进核心技术先进性，增强及保持公司的核心竞争优势。

综上所述，2024年半年度，公司核心竞争力未发生不利变化。

## 九、研发支出变化及研发进展

### 1、研发支出及变化情况

随着现有产品升级及新产品开发，公司持续加大研发投入，积极扩充研发人员数量、对研发人员进行股权激励以及购置研发相关无形资产。

2024 年 1-6 月，公司研发投入总额为 13,084.15 万元，较 2023 年同比增长 44.09%；其中，费用化研发投入 12,465.88 万元，资本化研发投入 618.28 万元。公司研发投入占营业收入比重为 66.74%，较去年同期增加 7.15 个百分点。

### 2、研发进展

核心技术的创新研发和成果转化是公司持续保持国际竞争力的关键基础和

驱动。2024 年上半年，公司坚持高强度研发投入，围绕工艺与设计协同优化进行技术和产品的战略布局，公司持续对核心技术进行研发、演进和拓展，在器件建模和电路仿真两个领域的技术上已率先突破，产品进入多家国际领先的集成电路设计及制造企业，并持续布局其他关键的核心 EDA 技术攻关和产品研发，目前已培育出标准单元库等同样具备先进性的 EDA 产品，正在加速推进具备国际市场竞争力的 EDA 全流程建设。目前公司已经拥有制造类 EDA 技术、设计类 EDA 技术、半导体器件特性测试技术三大类核心技术及其对应的 40 余项细分产品和服务。

2024 年 1-6 月，公司新增 3 件发明专利申请、1 件软件著作权申请。截至报告期末，公司累计获得的有效授权知识产权为 29 件发明专利、2 件实用新型专利、1 件外观设计专利、87 件软件著作权。

## **十、新增业务进展是否与前期信息披露一致**

不适用。

## **十一、募集资金的使用情况及是否合规**

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海概伦电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3703 号）以及上海证券交易所出具的《关于上海概伦电子股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（[2021]492 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 43,380,445 股，每股发行价格 28.28 元，募集资金总额为 1,226,798,984.60 元，扣除发行费用 111,830,322.05 元，募集资金净额为 1,114,968,662.55 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 22 日全部到位，并已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（大华验字[2021]000900 号）。

2024 年 1-6 月，公司实际使用募集资金金额为 9,077.72 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专项账户结余金额为 40,337.38 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额）。

2024 年 1-6 月，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《临时公告格式指引第十六号——上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和公司募集资金使用管理制度等相关规定及时、真

实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理及披露违规的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

## **十二、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况**

公司控股股东、实际控制人、董事长刘志宏直接持有公司股票 7,005.57 万股，本年度持股数未发生增减变动。

除上述情形外，公司其他董事、监事及高级管理人员未直接持有公司股份。

公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

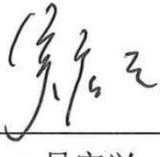
## **十三、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项**

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

(本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于上海概伦电子股份有限公司  
2024年半年度持续督导跟踪报告》之签章页)

保荐代表人：

  
姜 博

  
吴宏兴



2024年8月30日